



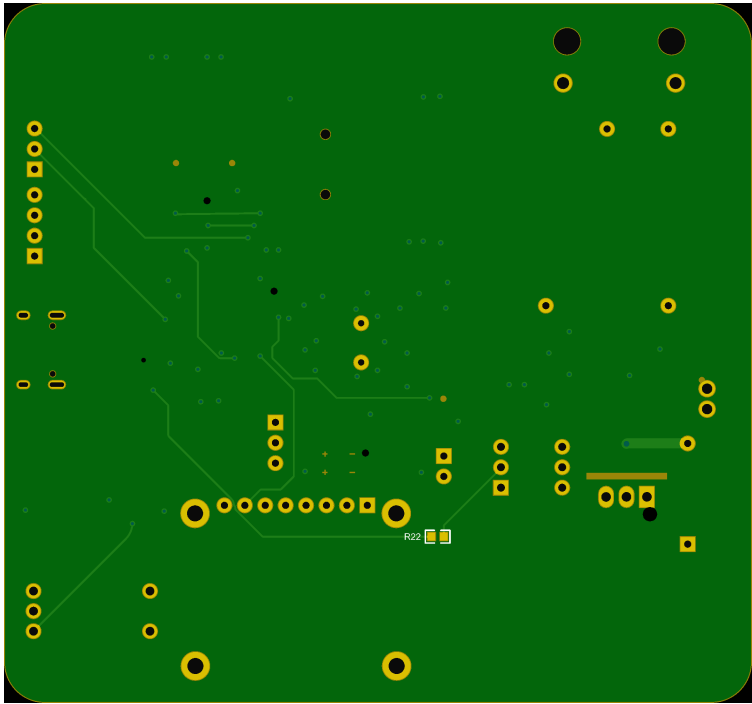
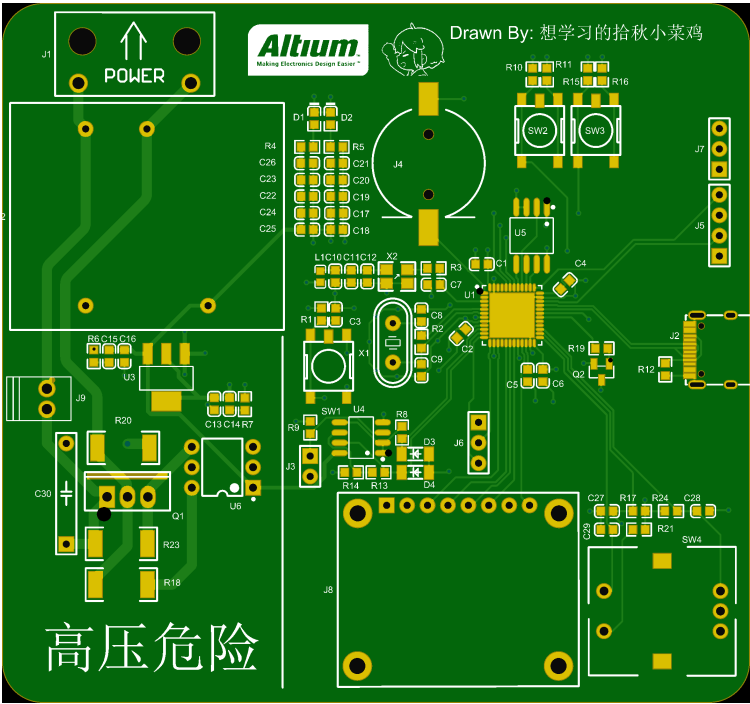
# 检查报告

时间2022-02-21

文件名: Heater




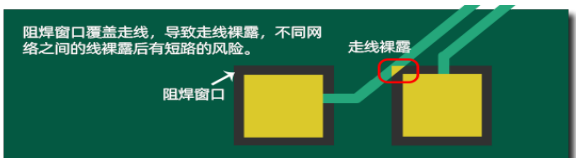
层数: 4

尺寸: 93.09\*87.12 mm



## 警示项

报告项目	类型	分析结果	描述与建议
SMD间距	不同网络SMD焊盘间距	0.17018 mm	<p>焊接时为避免焊盘过近无法保留阻焊桥，锡流动造成连锡短路的隐患，在设计时应考虑SMD焊盘之间的间距尽可能保留阻焊桥。焊盘边缘间距 &lt; 8mil 的需做沉金工艺。</p> <p>绿色阻焊桥：焊盘（Pad）边缘间距≥7mil； 黑油、白油：焊盘（Pad）边缘间距≥9mil； 其他颜色桥：焊盘（Pad）边缘间距≥8mil。</p> <p>您的“SMD焊盘”最小间距为6.70mil会影响生产效率、品质良率，而且存在连锡隐患，建议“SMD焊盘”最小间距 ≥ 8 mil</p>
焊盘规格	封装内间距异常	有异常	<p>焊盘大小、封装内间距设计与封装规格要求不一致，SMT加工时存在无法焊接的风险</p> <p>您的设计与封装规格要求的大小不一致，请排查问题</p>

焊盘规格	焊盘大小异常	有异常	 <p>您的设计与封装规格要求的大小不一致，请排查问题</p>
板边距离	SMD到板边距离	板边异常	 <p>您的“SMD焊盘到板边”最小间距为0.00mil，间距小于15.75mil，会影响焊盘的完整度，可能会导致焊锡不良，建议间距≥15.75mil</p>
孔上焊盘	过孔上焊盘	有	 <p>您的“设计”存在“孔在SMD焊盘上”，会影响焊盘的平整度，可能会导致焊锡不良。</p>
阻焊开窗	阻焊盖线	阻焊异常	 <p>您的文件“阻焊到线”小于0.34mil，走线被裸露可能会造成短路，影响产品电气性能。建议≥0.08mm</p>

全部检查项

报告项目	类型	分析结果
电气信号	断头线	✅ 正常
	孤立铜	✅ 正常
	无效过孔	✅ 正常
	片式SMD没连线路	✅ 正常
	锐角	✅ 正常
最小线宽	最小线宽	✅ 正常
最小间距	线到线	✅ 正常 0.151469 mm
	盘到线	✅ 正常 0.151469 mm
	盘到盘	✅ 正常 0.151469 mm

最小焊盘	BGA焊盘	✔ 正常
	常规焊盘	✔ 正常
	长条焊盘	✔ 正常
SMD间距	同网络SMD焊盘间距	✔ 正常
	不同网络SMD焊盘间距	❗ 9pis 0.17018 mm
	同器件焊盘间距	✔ 正常
	不同器件焊盘间距	✔ 正常
网格铺铜	网格线宽	✔ 正常
	网格线距	✔ 正常
孔大小	最小孔径	✔ 正常 0.4064 mm
	最大孔径	✔ 正常
	厚径比	✔ 正常
槽孔	最小槽宽	✔ 正常 0.599948 mm
	最大槽宽	✔ 正常
	槽长宽比	✔ 正常
孔环	过孔孔环	✔ 正常
	插件孔孔环	✔ 正常
孔到孔	同网络过孔	✔ 正常
	不同网络过孔	✔ 正常
	插件孔	✔ 正常
孔到线	过孔到表层	✔ 正常 0.304704 mm
	插件孔到表层	✔ 正常 0.304704 mm
	过孔到内层	✔ 正常
	插件孔到内层	✔ 正常
	NPTH到铜	✔ 正常

板边距离	铜/PAD/线到板边距离	✅ 正常
	SMD到板边距离	❗ 12pis 板边异常
	孔到板边	✅ 正常
特殊孔	半孔	✅ 正常
	盲埋孔	✅ 正常
	盲埋孔距离	✅ 正常
	激光孔	✅ 正常
	正/长方形孔	✅ 正常
焊盘规格	焊盘大小异常	❗ 1pis 有异常
	封装内间距异常	❗ 2pis 有异常
孔上焊盘	盘中孔	✅ 正常
	插件孔	✅ 正常
	过孔上焊盘	❗ 1pis 有
	非金属孔	✅ 正常
阻焊开窗	阻焊异常	✅ 正常
	阻焊盖线	❗ 2pis 阻焊异常
	阻焊间隙	✅ 正常
	同网络阻焊间隙	✅ 正常
	漏阻焊桥	✅ 正常
	同网络漏阻焊桥	✅ 正常
孔密度	孔密度	❗ 151个; 1.86万/m²
沉金面积	沉金面积	❗ 10.68%
飞针点数	飞针点数	❗ 343
Mark点	Mark点	✅ 正常
锣长分析	锣长分析	❗ 44.1685m/m²